

H10



Solder plus Support

免洗焊锡膏

高性能焊锡膏



主要特点

- ▶ 无卤素
- ▶ 当面积比为 0.5 时，
持续印刷效率 >90%
- ▶ BTC, BGA 和 LGA 上低空洞率
- ▶ 优异的润湿性能
- ▶ 消除虚焊 (NOW)
- ▶ 增强了所有低间隔元件上的
电化学可靠性
- ▶ 延长钢网寿命，工艺窗口宽

可用性

H10 可用于多种无铅合金。

H10 无卤免洗焊锡焊膏 专为最严格的应用而设计，包括汽车、LED照明和EMS组装。快速发展的技术和环境因素需要创新的解决方案。AIM的H10可在无铅、无卤、免洗的焊锡膏中提供强劲、稳定的性能，满足或超过当前RoHS、REACH和IPC要求。

👉 **H10 强效，可靠，适应性强。**

请联系 AIM 销售代表立即获取免费样品。

